



中华人民共和国国家标准

GB/T 17574.10—2003/IEC 60748-2-10:1994
QC 790107

半导体器件 集成电路 第 2-10 部分： 数字集成电路集成电路动态 读/写存储器空白详细规范

**Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 2-10: Digital integrated circuits—
Blank detail specification for integrated circuit
dynamic read/write memories**

(IEC 60748-2-10:1994, Semiconductor devices—
Integrated circuits—
Part 2: Digital integrated circuits—
Section 10: Blank detail specification for integrated
circuit dynamic read/write memories, IDT)

2003-11-24 发布

2004-08-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

前 言

《半导体器件 集成电路 数字集成电路》分为十三个部分：

——GB/T 5965—2000 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第一篇 双极型单片数字集成电路门电路(不包括自由逻辑阵列)空白详细规范(idt IEC 748-2-1:1991)

——GB/T 9424—1998 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第五篇 CMOS数字集成电路4000B和4000UB系列空白详细规范(idt IEC 748-2-5:1992)

——GB/T 17023—1997 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第二篇 HCMOS数字集成电路54/74HC、54/74HCT、54/74HCU系列族规范(idt IEC 748-2-2:1992)

——GB/T 17024—1997 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第三篇 HCMOS数字集成电路54/74HC、54/74HCT、54/74HCU系列空白详细规范(idt IEC 748-2-3:1992)

——GB/T 17572—1998 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第四篇 CMOS数字集成电路4000B和4000UB系列族规范(idt IEC 748-2-4:1992)

——IEC 60748-2-6 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第六篇：微处理器集成电路空白详细规范

——IEC 60748-2-7 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第七篇：熔丝式可编程双极只读存储器集成电路空白详细规范

——IEC 60748-2-8 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第八篇：集成电路静态读/写存储器空白详细规范

——IEC 60748-2-9 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第九篇：MOS紫外线擦除电可编程只读存储器空白详细规范

——IEC 60748-2-10:1994 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第十篇：集成电路动态读/写存储器空白详细规范

——IEC 60748-2-11 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第十一篇：单电源电可擦和可编程只读存储器空白详细规范

——IEC 60748-2-12 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第十二篇：可编程逻辑器件(PLDs)空白详细规范

——IEC 60748-2-20 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第二十二篇：低气压集成电路族规范

本部分为第10部分，等同采用IEC 60748-2-10:1994(QC 790107)《半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第10篇：集成电路动态读/写存储器空白详细规范》(英文版)。

本部分作了如下编辑性修改：

- 1) 删除IEC原文中的前言。
- 2) 将所有引用文件放入本部分正文，已经等同转化为国家标准的引用国家标准，否则引用IEC原文。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由中国电子技术标准化研究所(CESI)归口。

本部分起草单位：中国电子技术标准化研究所(CESI)。

本部分主要起草人：王琪、李燕荣。

半导体器件 集成电路 第 2-10 部分： 数字集成电路集成电路动态 读/写存储器空白详细规范

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 的章程,并在 IEC 的授权下进行工作。该体系的目的是确定质量评定程序,以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其他所有参加国同样接受。

本空白详细规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一,并且与下列标准一起使用。

GB/T 4728.12—1996 电气简图用图形符号 第 12 部分:二进制逻辑元件(idt IEC 617-12:1991)

GB/T 4937—1995 半导体器件机械和气候试验方法(idt IEC 749:1984, 修改单 1(1991),修改单 2(1993))

GB/T 17574—1998 半导体器件 集成电路 第 2 部分:数字集成电路(idt IEC 748-2:1985, 修改单 1(1991))

IEC 60068-2-17:1978 环境试验 第 2 部分:试验 试验 Q:密封

IEC 60134:1961 电子管、电真空管和类似的半导体器件的额定值体系

IEC 60747-10:1991/QC 700000 半导体器件 分立器件和集成电路 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

IEC 60748-11:1990/QC 790100 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)

要求的资料

本页和下页括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,这些资料应填入本规范相应的栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范和分规范的编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

- [5] 主要功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装资料。器件若具有若干种派生产品,则应指出其特性差异。

详细规范应给出包括以下的简短描述:

- 工艺(N MOS 等);
- 结构(字×位);
- 输出电路的形式(例如三态);
- 主要功能。
- [7] 外形图,引出端识别、标志和/或有关外形的参考文件。
- [8] 按总规范 2.6 的质量评定类别。
- [9] 参考数据。

[本规范下页方括号给出的条款构成了详细规范的首页,这些条款仅供指导详细规范的编写,而不应纳入详细规范中。]